

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 24 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 0 项、C 级 24 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



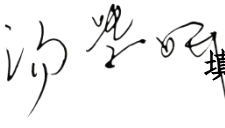
2025 年 05 月 20 日

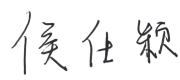
附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器 件 名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可 控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	MCU	JTLX32F103RET	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
2	MCU	JTLX32F103RET(W)	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
3	MCU	TLX32F103RET6	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
4	MCU	JTLX32F103ZET	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
5	MCU	JTLX32F103ZET(W)	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
6	MCU	TLX32F103ZET6	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
7	MCU	JTLX32F103VET	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
8	MCU	JTLX32F103VET(W)	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
9	MCU	TLX32F103VET6	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
10	MCU	JTLX32F103CET	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
11	MCU	JTLX32F103CET(W)	无锡泰连芯科 技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):

法定代表人(签章): 

填表人(签字):  电话: 13699386074 填报日期: 20250520

12	MCU	TLX32F103CET6	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
13	MCU	JTLX32F103TBU	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
14	MCU	JTLX32F103TBU(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
15	MCU	TLX32F103TBU6	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
16	MCU	JTLX32F103CBT	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
17	MCU	JTLX32F103CBT(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
18	MCU	TLX32F103CBT6	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
19	MCU	JTLX32F103RBT	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
20	MCU	JTLX32F103RBT(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
21	MCU	TLX32F103RBT6	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
22	MCU	JTLX32F103VBT	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
23	MCU	JTLX32F103VBT(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	
24	MCU	TLX32F103VBT6	无锡泰连芯科技有限公司	C	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 13699386074 填报日期: 20250520

- ^b. 应填写元器件完整型号规格;
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行, 分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行;
- ^e. “伪、空、包” 应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时, 则需要在“情况说明”写明判别因素; 若为“否”时, 则填“无”;
- ^f. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤学明

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074 填报日期: 20250520

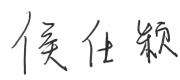
附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	MCU	JTLX32F103RET	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	MCU	JTLX32F103RET (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	MCU	TLX32F103RET6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
4	MCU	JTLX32F103ZET	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
5	MCU	JTLX32F103ZET (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
6	MCU	TLX32F103ZET6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
7	MCU	JTLX32F103VET	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
8	MCU	JTLX32F103VET (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填报单位(盖章):

法定代表人(签章): 

填报人(签字): 

电话: 13699386074

填报日期: 20250520

9	MCU	TLX32F103VET6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
10	MCU	JTLX32F103CET	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
11	MCU	JTLX32F103CET (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
12	MCU	TLX32F103CET6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
13	MCU	JTLX32F103TBU	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
14	MCU	JTLX32F103TBU (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
15	MCU	TLX32F103TBU6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
16	MCU	JTLX32F103CBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
17	MCU	JTLX32F103CBT (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

汤黎明

填表人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074 填报日期:20250520

18	MCU	TLX32F103CBT6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
19	MCU	JTLX32F103RBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
20	MCU	JTLX32F103RBT (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
21	MCU	TLX32F103RBT6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
22	MCU	JTLX32F103VBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
23	MCU	JTLX32F103VBT (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
24	MCU	TLX32F103VBT6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

^b. 应填写元器件完整型号规格;

^c. 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;

填报单位(盖章):

3202110176104

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 13699386074 填报日期: 20250520

- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤学明

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074 填报日期: 20250520